

Title (en)

Insulating system placed on roof rafters and method of making a shingle roof

Title (de)

Aufsparren-Dämmssystem für Hausdächer und Verfahren zur Herstellung eines Schindeldaches

Title (fr)

Système d'isolation placé sur des chevrons de toit et méthode de construction d'un toit en bardeaux

Publication

**EP 1113117 A2 20010704 (DE)**

Application

**EP 00128484 A 20001223**

Priority

DE 19963662 A 19991229

Abstract (en)

To erect a shingle roof, insulation boards (1) are used to support the shingles. The upper (3) and lower (4) skins of the boards (1) have a diffusion resistance of about 8 mu , and the insulation core (5) has a resistance of 20-70 mu . The insulation core (5) forms two projections and two recessed zones, in relation to the outer skins (3,4), with chamfers at the upper and lower edges of the core projections. The insulation boards (1) are locked together by tongues and grooves. Locking hooks (15) for the shingles are screwed to the upper skin (3) of the boards (1). The upper and lower skins (3,4) are of water-resistant medium density fiberboards (MDF).

Abstract (de)

Aufsparren-Dämmssystem für Hausdächer, bei welchem Dämmplatten (1) auf den Dachsparren (2) befestigt sind, welche eine Oberhaut (3) und eine Unterhaut (4) aus Holzmaterial wie insbesondere Holzfasermaterial und zwischen diesen einen mit Ober und Unterhaut verklebten Dämmstoffkern (5) aufweisen, wobei die Oberhaut direkt mit Schindeln belegt ist. Oberhaut und Unterhaut weisen einen Diffusionswiderstand von etwa 8 μ auf, der Dämmstoffkern einen solchen von etwa 20 bis 70 μ. Der Dämmstoffkern besitzt gegenüber Ober- und Unterhaut je zwei aufeinanderstoßende Überstände und zwei aneinanderstoßende Rücksprünge. Die oberen und unteren Kanten der Überstände des Dämmstoffkerns sind mit Abschrägungen versehen, so daß die Dämmplatten nut-federartig ineinander greifen. <IMAGE>

IPC 1-7

**E04B 7/22; E04D 3/35; E04D 13/12**

IPC 8 full level

**E04B 7/20** (2006.01); **E04B 7/22** (2006.01); **E04D 1/34** (2006.01); **E04D 1/36** (2006.01); **E04D 3/35** (2006.01); **E04D 13/12** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E04B 7/22** (2013.01); **E04B 7/225** (2013.01); **E04D 1/36** (2013.01)

Cited by

CN113235837A; US9709061B2; US9850906B2; US8770945B2; US9623161B2; US10245361B2; US9638202B2; US10117983B2; US11639722B2; US10166318B2; US10874782B2; US11724097B2; US10506935B2; US10856748B2; US11712167B2; US10371152B2; US11015605B2; US11781551B2; US9713663B2; US10052420B2; US10456513B2; US10980928B2; US11724094B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1113117 A2 20010704; EP 1113117 A3 20011024; EP 1113117 B1 20040915**; AT E276409 T1 20041015; DE 19963662 A1 20010719; DE 19963662 C2 20031016; DE 50007766 D1 20041021; DK 1113117 T3 20050110

DOCDB simple family (application)

**EP 00128484 A 20001223**; AT 00128484 T 20001223; DE 19963662 A 19991229; DE 50007766 T 20001223; DK 00128484 T 20001223